



POUR UNE FILIERE FRANCAISE LEADER DE L'ELECTRONIQUE DE PUISSANCE

EDITO, Rémi BASTIEN, directeur du Programme

Les deux derniers mois ont été très actifs sur le programme avec la préparation de l'IPCEI qui permettra une accélération des investissements industriels et donc la localisation en France pour atteindre notre objectif de prendre 25% du marché Européen. Les deux groupes de travail sur la standardisation et sur les compétences délivrent leurs premières conclusions et nous mettent en trajectoire. Il faut maintenant « transformer l'essai » dans les trois mois qui viennent !

Plan de soutien DGE

Un projet d'IPCEI « électronique et connectivité » sur la période 2021=>2025 couvrant aussi les filières aval comme l'automobile est en construction. DGE, PFA et CSF électronique sont d'accord pour couvrir au mieux l'ensemble de la chaîne de valeur et pas seulement l'assemblage final. Le dossier PFA a été remis à la DGE pour l'IPCEI en Avril 2021, pour une pré-notifications en Septembre 2021.

À ce stade 4 chefs de file sont identifiés :

- RENAULT,
- ST MICROELECTRONICS
- VALEO et
- VITESCO.

La DGE nous soutient fortement, mais il est essentiel de porter des dossiers d'excellence.

D'autres entreprises proposent d'intervenir en partenariat : E-MOTORS, ELVIA, APSI3D, MERSEN.

IPCEI et CORAM sont complémentaires (CORAM limité à TRL 6, IPCEI va à 9).

Tableau de bord

Le CA consolidé projeté 2025 du programme est estimé actuellement à 1,6 G€, en retrait par rapport à l'objectif fixé de 2,5 G€ (25% du marché en 2030).

Projets

51 entreprises participent aux 33 projets proposés en bottom-up, dont 19 ont été retenus par le programme et 6 sont déjà labellisés :

- Best cost to kW -APSI3D-, en recherche d'un apport industriel,
- SIEP -INVENTEC-, non retenu par le CORAM malgré un avis très favorable du Programme,
- SiCRET+ -IRT Saint Exupéry-, avec avis très favorable
- GaNRET -VEDECOM- qui aura un soutien fort des constructeurs au comité programme VEDECOM.
- LE REEVE -CIRTEM-, déposé dans le cadre du Plan de relance,
- PREMS -PREMS-, en attente de financement dans le cadre de l'AAP Résilience,

Aucun n'a obtenu de subvention à ce stade.

* Important Project of Common European Interest

Les autres projets accompagnés par le programme :

- Motopro HD (CEA)
- EffiGaN (MURATA)
- Mécatronique (EFI Automotive)
- NeoTwin (CENTUM ADENEO)
- Speci-PCB (Laboratoire Ampère-CNRS)
- HDM SiC / Tapir (G2ELAB)
- Matériaux sources/wafers SiC (ZADIENT)
- Ligne pilote (MEREDIT)
- Convertisseur intégré (SATIE)

Les projets de PUNCH POWERTRAIN, MCVE Tech et SEMA ont fusionné avec d'autres projets.

Pré-compétitif

Réunion du programme avec IRT St Exupéry pour jonction avec l'aéronautique.

GT Standardisation et benchmarking

Le GT a 3 objectifs :

- la standardisation de modules de puissance (>200V) pour les onduleurs Automobiles
- la standardisation des puces et boîtiers GaN pour les DC-DC et Chargeurs Automobiles et
- la Normalisation CEM Automobiles

Un benchmark modules de puissance (>200V) pour les onduleurs Automobiles a été réalisé.

Les critères de choix des solutions de modules de puissance (>200V) pour les onduleurs Automobiles sont déterminés.

Les travaux de spécification pour les modules de puissance (>200V) pour les onduleurs pour l'automobile (paramètres électriques, packaging, fiabilité) ont démarré (délai fin 2021).

GT Compétences

L'étude commune avec le CSF électronique sur les compétences et l'emploi dans le cadre de l'EDEC a été présentée.

3 sous-groupes ont été constitués :

- Reconversion / Formation continue,
- Alternance/ Apprentissage et
- Attractivité

pour réorganiser, simplifier, et créer une offre de formation cohérente pour répondre au besoin du secteur et proposer des actions vers les publics concernés pour faire connaître le secteur, ses enjeux et ses métiers.

GT Cycle de vie

Le GT est constitué avec pour objectif de faire une première analyse environnementale des principaux produits tels que onduleurs, DC/DC et OBCL'objectif de ce document sera d'analyser les principaux impacts et émettre des recommandations pour la filière sur les sujets (non exhaustif) :

- De l'emploi de matériaux critiques ou polluants
- Des procédés de fabrication associés et de leur localisation
- De la phase d'usage
- Du recyclage ou du réemploi / reconditionnement des produits en fin de vie

Recensement en cours des études disponibles sur le sujet

GT Extension Europe

Pour décider des thèmes de collaborations internationales (eg. Définition de standards), le GT souhaite d'abord fédérer les actions avec un Core Group National, et avoir de premiers résultats avant d'engager les contacts avec les acteurs européens non représentés dans le Programme EdP.

Participation au CLUB EUROPE (NextMove)

Thèmes et statut avant contacts dans le cadre d'appel européen à projets

Evénement

Le programme organise le 29 juin, en ligne, de 10h à 16h30, un Techshow pour permettre à la filière électronique de présenter ses innovations aux donneurs d'ordres automobiles.

Le programme est en construction, l'ouverture sera faite par Rémi BASTIEN, Directeur du Programme Electronique de puissance de la PFA et Thierry TINGAUD, Président du Comité Stratégique de filière « Industrie Electronique ». Il est prévu qu'une douzaine de fournisseurs puissent présenter leurs innovations, ces présentations seront enregistrées pour être accessibles ultérieurement. Un salon en présentiel pourra être organisé plus tard.

Contacts pôles :

- **CARA**: Thomas CREMOUX, thomas.cremoux@cara.eu 07 60 81 35 33
- **PVF** : Bruno JAMET, bj@vehiculedefutur.com 06 32 08 27 69
- **ID4Car** : Sebastien PERSONNIC, sebastien.personnic@id4car.org 07 61 29 28 80
- **NextMove** : Geoffroy MARTIN, geoffroy.martin@nextmove.fr 06 46 03 69 63
- **FIEV**: Stanislas BAILLY, sbailly@sneci.com 06 87 53 35 38
- **I-Trans** : Jean-Maxime BOULANGER, jean-maxime.boulanger@i-trans.org 06 64 83 15 96